

Title (en)

Process and apparatus for monitoring and controlling the flat galvanic deposition of thick layers on electrically conductive flexible substrates

Title (de)

Verfahren und Vorrichtung zur Überwachung und Steuerung der flächigen galvanischen Abscheidung dicker Schichten auf elektrisch leitfähigen flexiblen Substraten

Title (fr)

Procédé et dispositif de surveillance et de contrôle de dépôt galvanique à plat de couches épaisses sur des substrats conducteurs électriques, flexibles

Publication

EP 0828016 A1 19980311 (DE)

Application

EP 97110612 A 19970628

Priority

DE 19636492 A 19960909

Abstract (en)

To monitor and control the electro plating deposition of layers on electrically conductive and flexible substrates, a distortion of the substrate (14,51) is measured directly at the substrate during the plating action. The measured distortions are evened out by variation of the process parameters in parallel with the measuring operation. Also claimed is an appts. with a monitor (18,19) at the rear side of the substrate (14) to measure substrate movement.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Überwachung und Steuerung der flächigen galvanischen Abscheidung dicker Schichten auf elektrisch leitfähigen flexiblen Substraten, wobei eine Verformung des Substrats (14, 51) direkt am Substrat während des Galvanisiervorganges gemessen und die während des Galvanisiervorganges gemessene Verformung durch Variation der Verfahrensparameter parallel zum Meßvorgang ausgeglichen wird. Durch vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung läßt sich insbesondere der Stofftransport zum Substrat (14) kontrollieren und beeinflussen. <IMAGE>

IPC 1-7

C25D 21/12

IPC 8 full level

C25D 21/12 (2006.01)

CPC (source: EP)

C25D 21/12 (2013.01)

Citation (search report)

- [A] US 3356605 A 19671205 - SCHMIDT FRANCIS J
- [A] US 4786376 A 19881122 - VAALER LUTHER E [US]
- [A] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 018, no. 082 (C - 1164) 10 February 1994 (1994-02-10)

Designated contracting state (EPC)

DE ES FR GB IT SE

DOCDB simple family (publication)

EP 0828016 A1 19980311; DE 19636492 A1 19980312; DE 19636492 C2 19990121

DOCDB simple family (application)

EP 97110612 A 19970628; DE 19636492 A 19960909